Your Partner of Advanced Materials & Mass Lam Service

聯茂電子

第三季營運說明

免責聲明



- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊, 其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性 資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於 市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本 公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新



公司介紹

公司現況



成立日期 : 1997年4月10日

● 總部地址 :台灣省新竹縣新埔鎮大魯閣路17號

● 實收資本額:NT\$30.29億

● 員工人數 : 2,906人

● 董事長 : 蔡茂禎

執行長 : 蔡馨暳

● 技術長 : Tarun Amla

產能 : 銅箔基板 325萬張/月

膠片 1480萬米/月

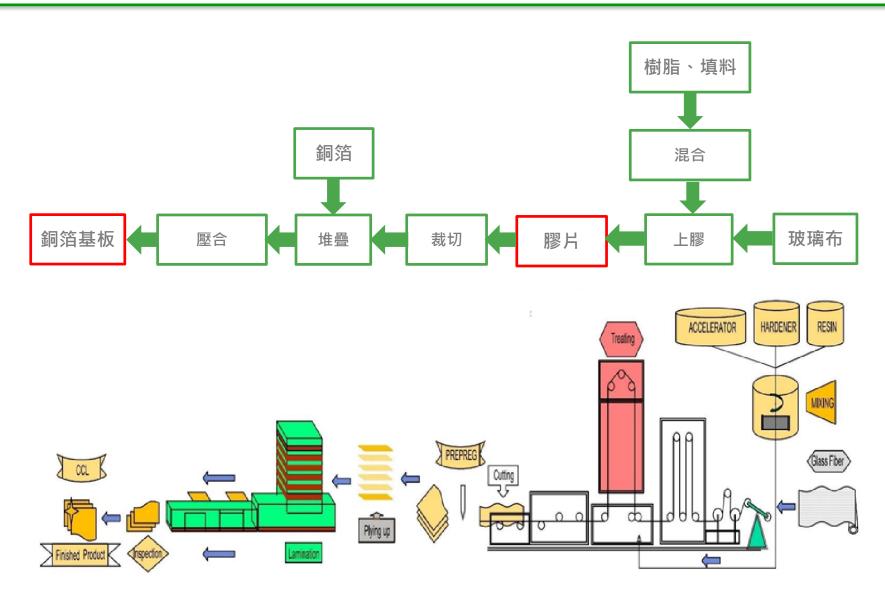
軟性銅箔基板 89萬坪米/月

多層壓合代工 50萬平方英尺/月



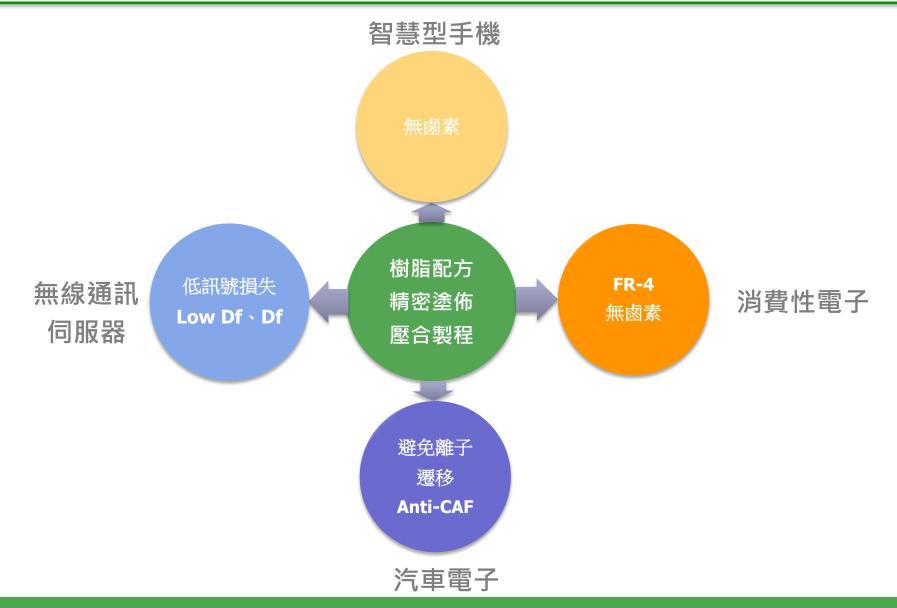
銅箔基板&膠片製造流程





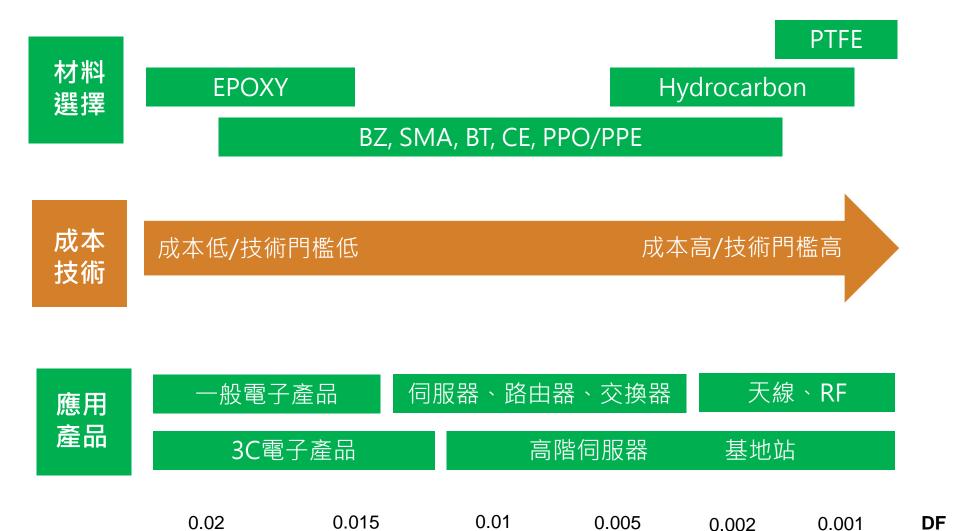
核心技術





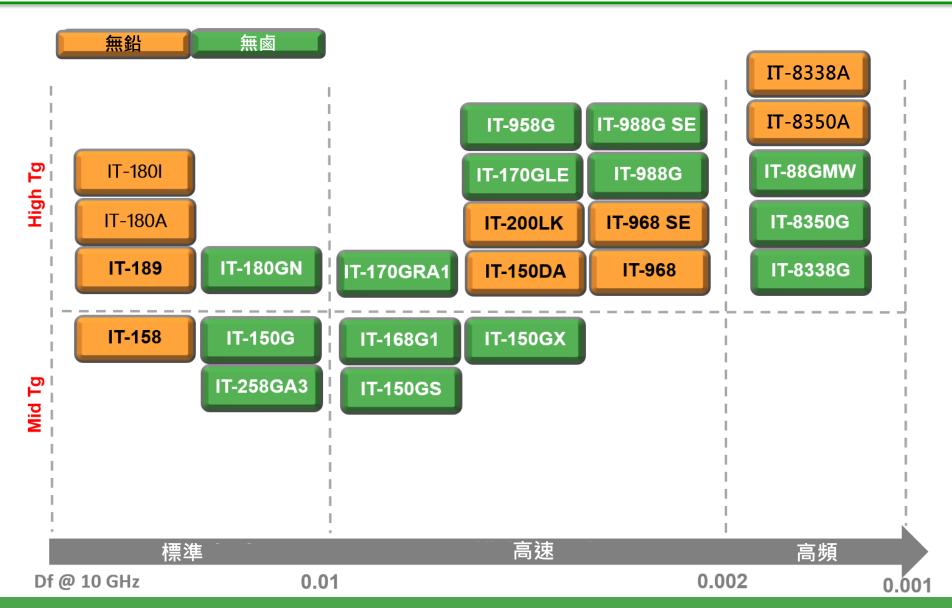
材料發展





產品線





廠區分布與每月產能





無錫廠

基板:180 萬 張 膠片:850 萬 米



新埔廠(台灣)

基板:45 萬 張 膠片:180 萬 米



東莞廠

基板:100 萬 張 膠片:450 萬 米



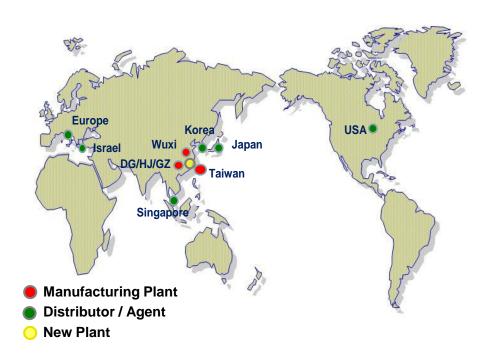
廣州廠(軟性銅箔基板)

3 Layer FCCL: 75 萬 平方米 2 Layer FCCL: 14 萬 平方米



黃江廠

壓合代工:50 萬 平方呎



江西廠 (第一期)

基板:60 萬 張 膠片:450 萬 米

量產時程:3Q,2019



財務表現

營收與毛利率

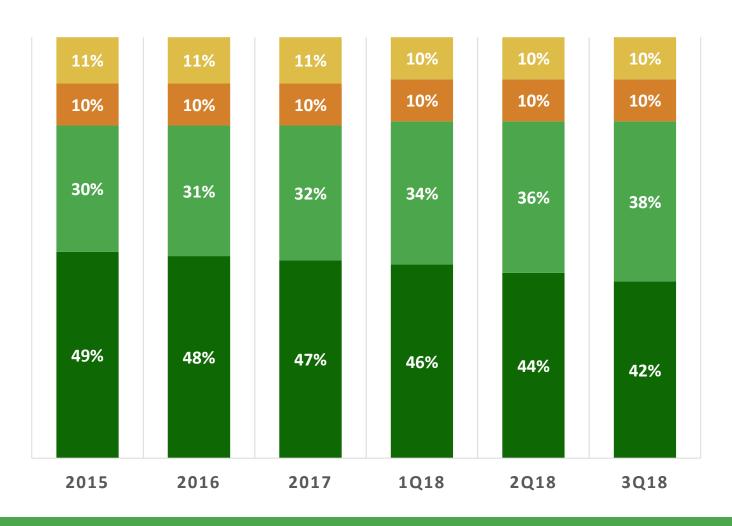


(新台幣 百萬元)



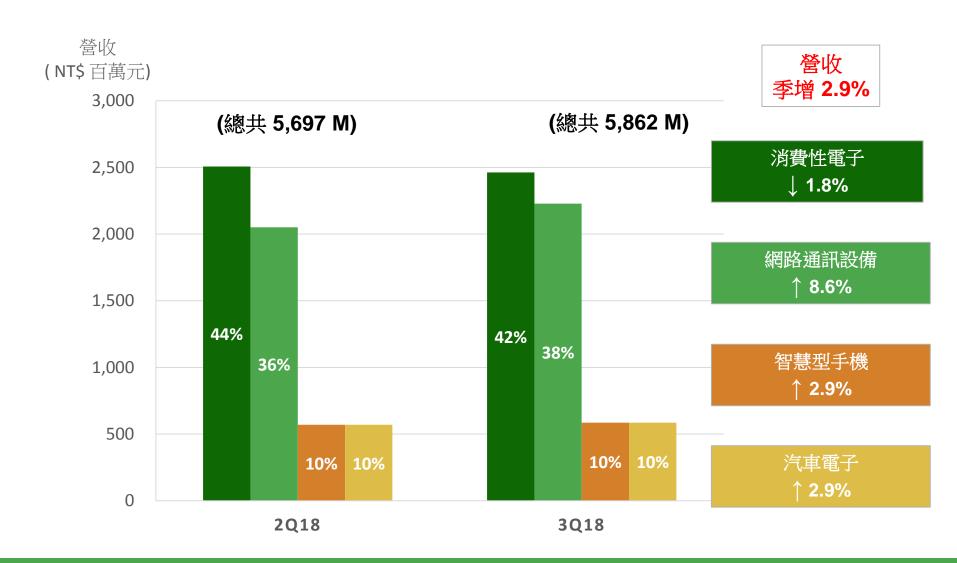






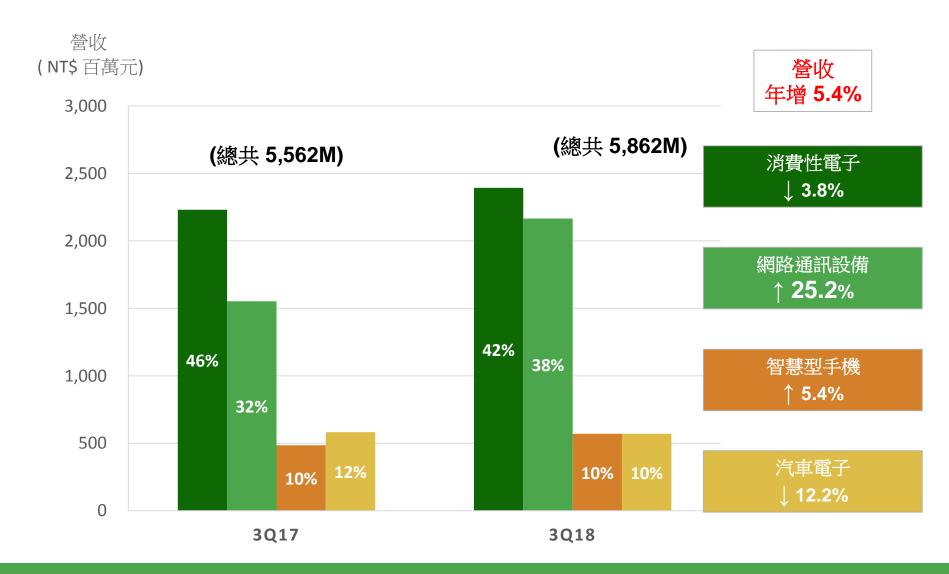
季增減比較





年增減比較





2017與2018 第三季度損益表



NT\$ 百萬元	2017Q3	2018Q3
營業收入	5,562	5,862
營業毛利	821	927
營業費用	356	353
營業利益	465	575
營業外收入及支出	55	(34)
稅前淨利	519	540
所得稅費用	157	141
歸屬於母公司淨利	362	399
每股盈餘(NT\$)	1.20	1.31

重要財務比率(%)	2017Q3	2018Q3
毛利率	14.75	15.82
營業費用率	6.40	6.01
營業利益率	8.35	9.80
有效稅率	30.28	26.18
淨利率	6.51	6.81

2017與2018 第三季度資產負債表



NT\$ 百萬元	2017Q3	2018Q3
資產總額	18,334	19,001
現金及約當現金	3,624	3,536
短期投資	538	27
應收帳款/票據	7,875	8,941
存貨	1,662	2,145
固定資產	2,932	2,753
負債總額	11,316	11,600
短期債務	3,457	3,389
應付帳款/票據	4,600	5,409
長期債務	1,153	1,035
股東權益總額	7,019	7,401

重要財務比率 (%)	2017Q3	2018Q3
應收帳款週轉天數	137	137
存貨週轉天數	32	36
應付帳款週轉天數	94	96



市場趨勢

市場趨勢



● 全球數據流量高速成長

- 超高畫質影音串流
- 物聯網相關應用 (智慧家庭、遠端醫療與自駕車)
- 大數據分析與人工智慧
- 雲端運算與雲端儲存
- 虛擬實境(VR) 與擴增實境 (AR)



全球數據流量大幅成長,將帶動網路服務營運商及電信商更新設備來滿足需求

市場趨勢



● 資料處理速度提升

- PCIe4.0傳輸速率將提升至16Gbps, 比現行PCIe3.0提升1倍
- 近期PCIe5.0標準制定中,預計傳輸速率將提升至32Gbps

● 5G網絡實現並商轉

- 傳輸速率達1~10Gbps,較4G提升10~100倍
- 5G傳輸的頻率變高,涵蓋的範圍變小,基地台的需求隨之增加
- 巨量天線(Massive MIMO)與毫米波高頻傳輸技術將使基站天線數量由十幾根增加至上百根

電子基材升級為實現高頻高速時代之必須

- 更低的介電常數 (Dielectric constant, Dk) 與低損耗因子 (Dissipation factor, Df)
- 更高的可靠度與穩定度
- 高耐熱與導熱

5G 網絡架構及商機



核心網絡(電信商資料中心):

包含 伺服器、儲存器、交换器與光通訊模組

高速材料

基帶處理單元(BBU)

- 實現低訊號延遲, 高速傳輸處理
- 包含 宏基站 到 小基站

高速材料

射頻拉遠單元(RRU)+ 天線

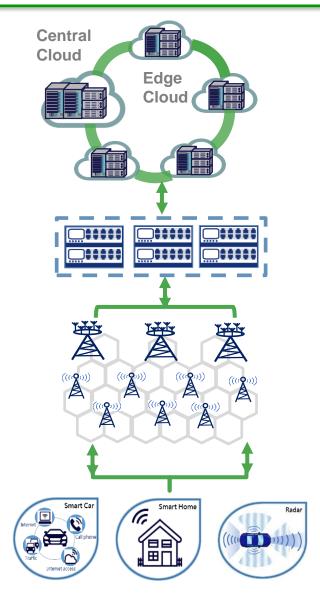
- 包含天線、功率放大器模組與射頻模組
- 高多層設計因應功能複雜化

高速材料

高頻材料

IOT(Internet of Things):

高速材料



下世代網路通訊設備與手機材料需求



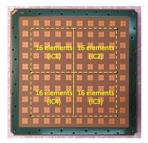
- ITEQ 材料解決方案 -- 網路通訊
- Middle Low Loss: 伺服器Purley 平台
- Low Loss: 下一世代PCIE 4.0 伺服器平台
- Ultra Low Loss: 5G通訊基站、背板
- RF Microwave: 天線、功率放大器模組、濾波器



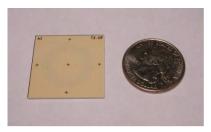
- Standard:中低階智慧型手機
- Low Dk Material: 高階智慧型手機
- High Tg, Low Dk Material: 類載板MSAP製程
- Low Dk Low Loss Material: 5G手機評估











Typical Phased Array Modular Units

下世代汽車電子材料需求



- 市場持續成長
 - 車用PCB產值:

美金 490億/2015 — 美金 750億 /2020 (Source: NTI Information)

提供完整的車用產品材料

自動駕駛



• 自動駕駛輔助系統

高頻材料

• 77~79GHz 雷達

車聯網



• 影音娛樂系統

HDI材料

高速材料

• 多層 HDI板

動力系統



- 電動車
- 充電系統

High Tg 材料

- 大電流
- 大電壓
- 厚銅





Thank You

